

# 投资者关系活动记录表

证券简称：晶升股份

股票代码：688478

编码：〈2023-009〉

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	华夏基金、东吴证券
时间	2023-11-16
地点	公司会议室
公司接待人员姓名	董事长、总经理：李辉
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>问答环节</b></p> <p><b>Q:国内的一些碳化硅衬底头部企业都陆续获得海外大厂的订单，这对于国产碳化硅衬底产业来说具有重要的意义。从公开披露的季报来看，天岳也在3季度取得了盈利。请问这样的盈利和发展是否是可持续的？</b></p> <p>A:我们认为是可持续的，盈利和发展都主要来自于技术的进步。据我们了解，近年来国产碳化硅衬底制备技术不断升级且取得了飞跃性的突破。以天岳为代表的国产衬底的出海不仅说明了头部企业的产能已经得到较大程度的提升，另一方面也证明国产衬底的品质取得了显著的进步，在产品的可靠性和一致性上已获得了国际大厂的认可。影响碳化硅衬底厂商盈利的主要因素是衬底的良率水平。因此，受益于衬底制备技术的持续进步和良率水平的不断提升，碳化硅衬底成本也将得到进一步优化，从而为企业的持续盈利能力带来积极正向的影响。</p> <p><b>Q:800v高压快充电动汽车基本采用进口碳化硅器件，请问国产碳化硅器件何时可以全面“上车”并替代进口？</b></p> <p>A:在工业级MOS方面，目前国产碳化硅器件已实现应用，然而国产器件大规模“上车”仍需要一定的时间。但我们相信，随着技术的不断进步升级和产业链上下游的协同发展，预计2025年左右国</p>

产碳化硅器件有望开始替代进口。

**Q: 根据公司之前披露的相关信息，公司产品已销往台湾市场，请问是样机还是批量订单？**

A: 公司积极开拓中国台湾市场并与客户保持密切的技术交流，目前已经取得批量订单且订货数量持续增加。此外，公司也正积极布局中国台湾地区以外的海外市场。

**Q: 公司向台湾客户销售的产品是硅还是碳化硅的长晶设备？另外，在台湾地区，公司的主要竞争对手有哪些？主要是国内设备厂商还是国外厂商？**

A: 公司的半导体级单晶硅炉和碳化硅单晶炉都已在中国台湾成功交付并验收，设备在客户现场表现良好。我们在台湾地区的主要竞争对手为德国、韩国以及日本等国外设备厂商。